**中国射频芯片行业市场发展分析及前景趋势与投资研究报告(2024-2029版)**

**报告简介**

射频芯片指的就是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形，并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件，它包括功率放大器、低噪声放大器和天线开关。射频芯片架构包括接收通道和发射通道两大部分。

在射频芯片领域，市场主要被海外巨头所垄断，海外的主要公司有Qorvo，skyworks和Broadcom;国内射频芯片方面，没有公司能够独立支撑IDM的运营模式，主要为Fabless设计类公司;国内企业通过设计、代工、封装环节的协同，形成了“软IDM”的运营模式。射频芯片设计方面，国内公司在5G芯片已经有所成绩，具有一定的出货能力。射频芯片设计具有较高的门槛，具备射频开发经验后，可以加速后续高级品类射频芯片的开发。目前，具备射频芯片设计的公司有紫光展锐、唯捷创芯、中普微、中兴通讯、雷柏科技、华虹设计、江苏钜芯、爱斯泰克等。

射频芯片代工方面，台湾已经成为全球最大的化合物半导体芯片代工厂，台湾主要的代工厂有稳懋、宏捷科和寰宇，国内仅有三安光电和海威华芯开始涉足化合物半导体代工。三安光电是国内目前国内布局最为完善，具有GaAs HBT/pHEMT和GaNSBD/FET工艺布局，目前在于国内200多家企事业单位进行合作，有10多种芯片通过性能验证，即将量产。海威华芯为海特高新控股的子公司，与中国电科29所合资，目前具有GaAs0.25umPHEMT工艺制程能力。射频芯片封装方面，5G射频芯片一方面频率升高导致电路中连接线的对电路性能影响更大，封装时需要减小信号连接线的长度;另一方面需要把功率放大器、低噪声放大器、开关和滤波器封装成为一个模块，一方面减小体积另一方面方便下游终端厂商使用。为了减小射频参数的寄生需要采用Flip-Chip、Fan-In和Fan-Out封装技术。

上一轮射频前端市场始于4G时代，全网通的需求大大增加了覆盖的频段数量，常用频段数量从3G时代的10个左右增加到4G时代的40个左右，极大地推动了射频前端的发展。受益于5G网络的商业化建设，自2020年起全球射频前端芯片市场将迎来快速增长，2021年进一步增长至235.6亿美元。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国射频芯片市场进行了分析研究。报告在总结中国射频芯片发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国射频芯片的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为射频芯片企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

**报告目录**

**第一章 射频芯片行业定义及产业链分析**

第一节 射频芯片定义及产品分类

一、射频芯片定义

二、射频芯片产品分类及主要功能

三、射频模组及集成度

第二节 射频芯片产业链结构图

第三节 射频芯片产业链上游市场分析

一、砷化镓(gaas)半导体材料市场分析

二、碳化硅(sic)半导体材料市场分析

三、氮化镓(gan)半导体材料市场分析

第四节 射频芯片产业链下游市场分析

一、全球智能手机市场发展分析

二、中国智能手机市场发展分析

**第二章 中国射频芯片行业发展宏观环境分析**

第一节 射频芯片行业发展政策环境分析

一、行业监管体系及职能

二、行业政策规范汇总

三、行业重点规划解读.

四、行业政策环境影响分析

第二节 射频芯片行业发展经济环境分析

一、全球经济发展现状分析

二、主要国家经济发展现状

三、中国经济发展现状分析

四、全球主要经济体经济展望

五、行业经济环境影响分析

第三节 射频芯片行业发展技术环境分析

一、5g技术对射频芯片行业发展影响分析

二、射频芯片行业专利申请情况

三、行业企业技术研发投入情况

四、行业最新研发动态.

五、行业技术环境影响分析

第四节 射频芯片行业发展贸易环境分析

一、中美贸易战梳理及最新进展

二、贸易战对于射频芯片行业发展影响分析

第五节 疫情影响射频芯片行业发展机遇与挑战

**第三章 全球及中国射频芯片行业发展现状分析**

第一节 全球及中国射频芯片行业发展特点分析

一、行业市场集中度高

二、射频器件模组化趋势明显

三、国内企业多聚焦分立器件市场

四、部分产品国产替代进行时

第二节 全球及中国射频芯片行业市场规模分析

一、全球射频芯片行业市场规模现状

二、中国射频芯片行业市场规模现状

第三节 全球及中国射频芯片行业竞争格局分析

一、全球总体企业格局

二、全球总体细分产品格局

三、国内企业射频芯片业务布局

**第四章 全球及中国射频芯片行业细分产品市场分析**

第一节 滤波器市场分析

一、滤波器产品简介

二、滤波器市场规模分析

三、滤波器市场竞争格局

四、滤波器需求前景预测

第二节 功率放大器(pa)市场分析

一、功率放大器(pa)产品简介

二、功率放大器(pa)市场规模分析

三、功率放大器(pa)市场竞争格局

四、功率放大器(pa)需求前景预测

第三节 射频开关市场分析

一、射频开关产品简介

二、射频开关市场规模分析

三、射频开关市场竞争格局

四、射频开关需求前景预测

第四节 低噪放(lna)市场分析

一、低噪放(lna)产品简介

二、低噪放(lna)市场规模分析

三、低噪放(lna)市场竞争格局

四、低噪放(lna)需求前景预测

第五节 射频模组市场分析

一、射频器件模组化优势分析

二、射频模组市场规模分析

三、射频模组市场竞争格局

四、射频模组需求前景预测

**第五章 全球及中国射频芯片行业投资兼并及重组分析**

第一节 行业投资兼并及重组特点分析

第二节 行业投资兼并及重组动因分析

第三节 行业投资兼并及重组规模分析

第四节 行业投资兼并及重组趋势展望

**第六章 全球射频芯片行业重点企业分析**

第一节 skyworks

一、企业简介

二、企业发展历程

三、企业射频芯片产品布局

四、企业经营业绩情况

五、企业核心客户

第二节 qorvo

一、企业简介

二、企业发展历程

三、企业射频芯片产品布局

四、企业经营业绩情况

五、企业核心客户

第三节 avago

一、企业简介

二、企业发展历程

三、企业射频芯片产品布局

四、企业经营业绩情况

五、企业核心客户

第四节 murata

一、企业简介

二、企业发展历程

三、企业射频芯片产品布局

四、企业经营业绩情况

五、企业核心客户

第五节 qualcomm

一、企业简介

二、企业发展历程

三、企业射频芯片产品布局

四、企业经营业绩情况

五、企业核心客户

**第七章 中国射频芯片行业重点企业分析**

第一节 江苏卓胜微电子股份有限公司

一、企业基本信息

二、企业主营业务分析

三、企业射频芯片产品布局

四、企业研发创新能力

五、企业经营业绩情况

六、企业重点客户

七、企业核心竞争力

第二节 上海韦尔半导体股份有限公司

一、企业基本信息

二、企业主营业务分析

三、企业射频芯片产品布局

四、企业研发创新能力

五、企业经营业绩情况

六、企业重点客户

七、企业核心竞争力

第三节 深圳市信维通信股份有限公司

一、企业基本信息

二、企业主营业务分析

三、企业射频芯片产品布局

四、企业研发创新能力

五、企业经营业绩情况

六、企业重点客户

七、企业核心竞争力

第四节 昂瑞微电子技术有限公司

一、企业基本信息

二、企业主营业务分析

三、企业射频芯片产品布局

四、企业研发创新能力

五、企业经营业绩情况

六、企业重点客户

七、企业核心竞争力

第五节 三安光电股份有限公司

一、企业基本信息

二、企业主营业务分析

三、企业射频芯片产品布局

四、企业研发创新能力

五、企业经营业绩情况

六、企业重点客户

七、企业核心竞争力

第六节 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

一、企业基本信息

二、企业主营业务分析

三、企业射频芯片产品布局

四、企业研发创新能力

五、企业经营业绩情况

六、企业重点客户

七、企业核心竞争力

第七节 深圳紫光展锐科技有限公司

一、企业基本信息

二、企业主营业务分析

三、企业射频芯片产品布局

四、企业研发创新能力

五、企业经营业绩情况

六、企业重点客户

七、企业核心竞争力

第八节 深圳顺络电子股份有限公司

一、企业基本信息

二、企业主营业务分析

三、企业射频芯片产品布局

四、企业研发创新能力

五、企业经营业绩情况

六、企业重点客户

七、企业核心竞争力

**第八章 中国射频芯片行业投资前景及策略建议**

第一节 中国射频芯片行业发展前景展望

一、行业发展影响因素分析

二、行业发展趋势分析

三、行业发展前景预测

第二节 国射频芯片行业投资壁垒分析

一、资金壁垒

二、技术壁垒

三、客户壁垒

第三节 国射频芯片行业投资风险分析

一、5g技术应用不及预期

二、产品研发不及预期

三、客户拓展不及预期

第四节 中国射频芯片行业投资机会分析

一、5g落地带来的投资机会

二、中美贸易战带来的市场机会

三、顶层政策出台带来的发展机会

**第九章 2024-2029年中国射频前端芯片行业发展趋势和前景预测分析**

第一节 射频前端芯片发展前景展望

一、手机射频前端发展潜力

二、基站射频前端空间预测

三、射频前端市场空间测算

第二节 2024-2029 年射频前端芯片行业发展预测

一、2024-2029年射频前端芯片影响因素分析

二、2024-2029年射频前端芯片市场规模预测

**图表目录**

图表：2019-2023年全球砷化镓元件市场规模(单位：亿美元)

图表：2019-2023年全球碳化硅器件市场规模(单位：亿美元)

图表：2019-2023年全球氮化镓器件市场规模(单位：亿美元)

图表：2019-2023年全球智能手机出货量(单位：亿台)

图表：2019-2023年中国智能手机出货量(单位：亿台)

图表：射频芯片相关政策

图表：华为专利

图表：2019-2023年全球射频前端行业市场规模(单位：亿美元)

图表：2019-2023年中国射频前端芯片行业市场规模(单位：亿元)

图表：全球射频前端市场竞争格局(单位：%)

图表：射频前端细分结构价值量占比情况

图表：2019-2023年全球滤波器市场规模(单位：亿美元)

图表：2019-2023年全球射频放大器市场规模(单位：亿美元)

图表：射频pa国内厂商情况

图表：产品布局

图表：企业产品布局

图表：2024-2029年中国射频前端芯片市场规模预测(单位：亿元)

**把握投资 决策经营！**  
**咨询订购 请拨打 400-886-7071 邮件 kf@51baogao.cn**  
本文地址：https://www.51baogao.cn/baogao/20230106/311803.shtml

[在线订购>>](https://www.51baogao.cn/baogao/20230106/311803.shtml)